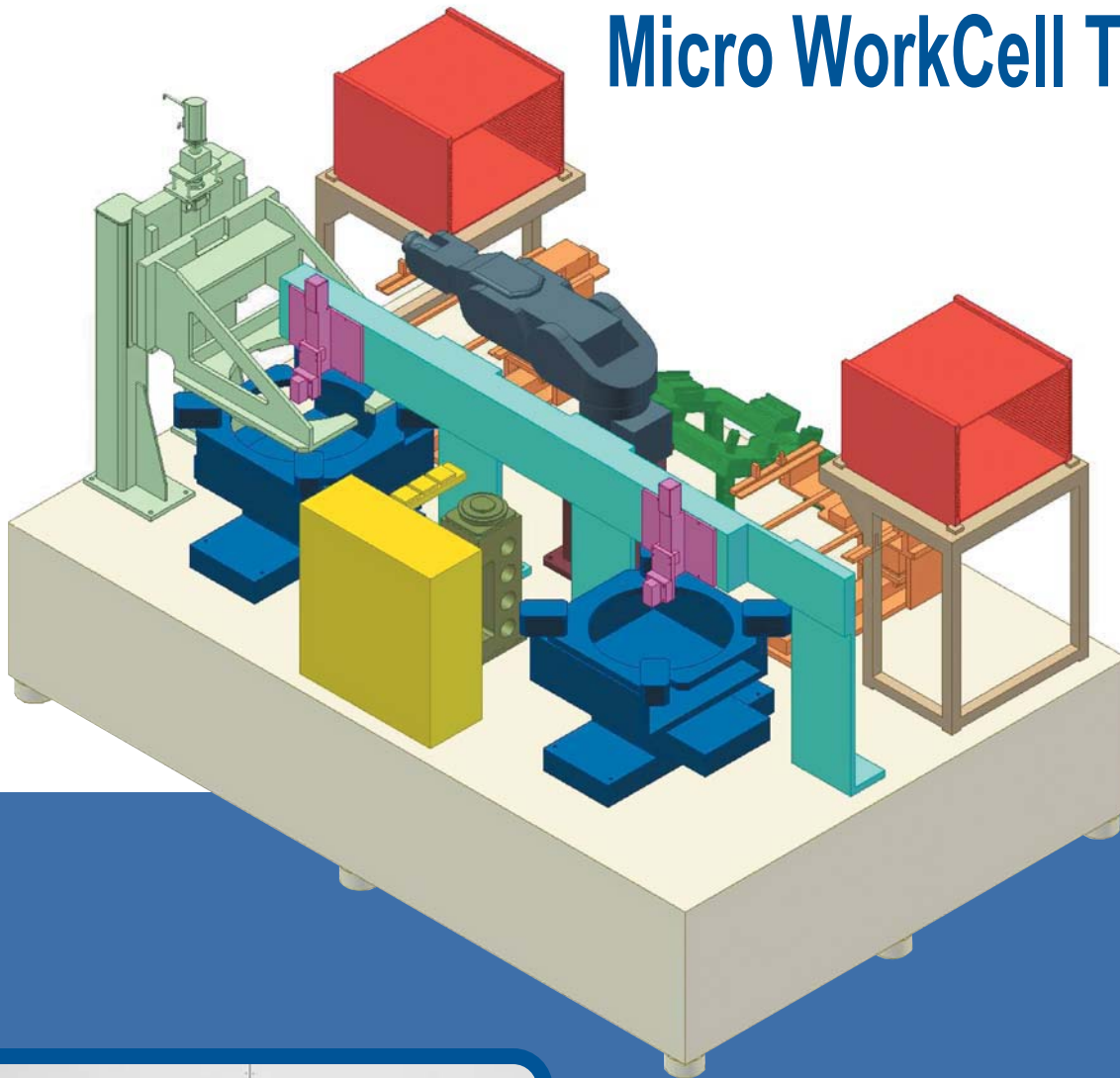


New product

# 300mmCOW (チップオンウエハー)

## Micro WorkCell TYPE3000



■高ボンド精度 — — ±1 μm ~ 15 μm

■UPH — — — ~2000

■ウェハサイズ — — — 100 ~ 300mm

ハンドリングロボットによる自動搭載

# AJI

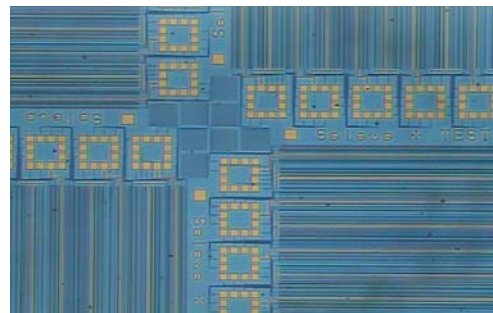
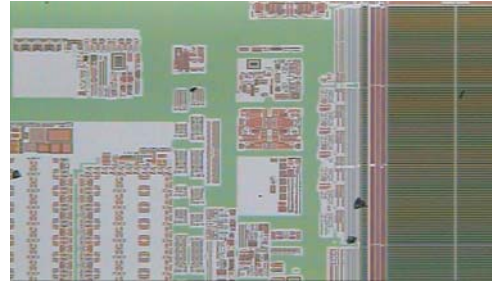
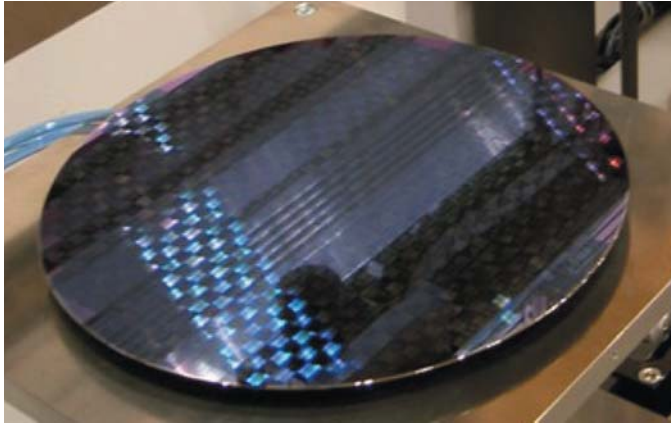
Advanced Jisso Technology

高精度精密装置

# Micro WorkCell TYPE3000

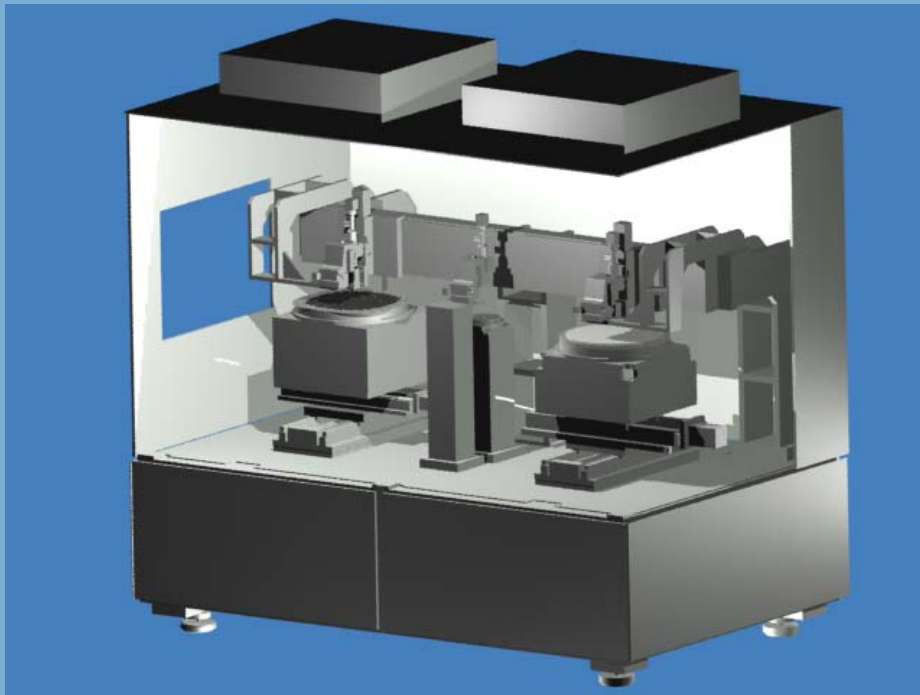
Advanced Jisso Technology

ウェハからウェハへ直接加工 チップボンダーとして チップ ソータとして



Waferレベルパッケージに最適

半導体・MEMS・光学系部品・CMOS等・・・



ウェハサイズ・・・100～300mm

搭載精度・・・1 $\mu$ m～15 $\mu$ m

UPH・・・・・・・～2000

光部品組立・MEMS組立・半導体実装など。  
幅広い分野に対応



AJI Co.,Ltd

神奈川県横浜市中区新港2-2-1

横浜ワールドポーターズ6階

Tel:045-222-2985

Fax:045-222-2986

info@ajisso.com

http://www.ajisso.com

海外オフィス

米国 AJ Industries LLC

台湾 AJI Taiwan

韓国 AJI Korea